LONGAIN
烟台长盈电子科技有限公司

产品技术资料
UF8519C
2016.06

产品描述

UF8519C 底部填充胶是单组分热固化的环氧胶。可快速固化，具有高粘接性能、低模量和可修复性。耐候性佳，贮存稳定性好。可用于喷涂应用。

典型用途

用于倒装芯片中球栅阵列（BGA）和芯片尺寸封装（CSP）等的封装中。

固化前胶液性能

颜色.....浅黄色
比重 （GB/T 15223） 1.12
粘度 (cps @ 25℃) (GB/T2794)..... 800
适用期（GB/T 7123.1-2002）..... 3天 @25℃
固化方式 .....10min @120℃
8min@150℃

固化后性能

（以下性能在120℃固化30分钟条件下测得）

剪切强度(MPa)（GB/T 7124-2008） 8.5
玻璃化温度(℃)（ISO1357-2）..... ...51
热膨胀系数(ppm/℃)（ASTM E228）.....58
硬度（邵氏D）（GB/T 531.1-06） 82
耐溶剂性 （GB/T 13353） ..... 良好
可返修性 .....良好

体积电阻率（Ω·cm）（GB/T1692）.....6.5×10^{15}

* 标准条件：温度23±2℃、相对湿度50±5%

使用方法

1. 将产品从冰箱取出，室温放置1～2小时，使胶液温度达到室温水平。在回温过程中请勿打开包装瓶盖或针筒堵头。针筒包装回温时需保持头向下竖直放置。
2. 本胶水可满足手工和自动施胶的要求，在分装或装配的过程中需避免在胶水引入气泡。
3. 填充过程中根据工艺要求可在室温下进行或对电路板进行预热。选用合适的针头及气压，沿元器件边缘呈“I”或“L”形施胶，静置等待胶液自动填充满元件底部。
4. 升温至工艺要求温度,加热固化胶水。
5. 未用完的胶水应尽快密封重新保存于冰箱中。不可与未使用的胶水混合保存。
6. 返修时先加热器件至焊点融化温度以上，镊子轻夹边角取下器件，用热烙铁小心刮除PCB上残余的胶体和焊锡。使用丙酮或其它合适溶剂清洗表面。

贮存方法和保质期

在阴凉、干燥处贮存，2~8℃保质期6个月。

注意事项

本产品固化后为安全无毒物质，但固化前应尽量避免与皮肤接触，若不慎溅入眼睛，应迅速用大量清水冲洗。

详细安全数据参见安全数据表。

声明

本文中所涉及的技术数据均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，被认为是可靠的。但由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同、固化条件不同，实际性能数据有一些变化属正常现象。贮存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，公司不承担责任。建议用户在正式使用前，应根据本文提供的数据进行实验。